

## 裕太微电子股份有限公司

证券代码: 688515 证券简称: 裕太微

## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: YT\_ZQSWB\_2024\_3\_7

投资者关系活动类别	□公司现场接待 ☑其他场所接待	□电话接待 □公开说明会	裕太微电子 Mocarcomin
	□定期报告说明会		
	□其他 ( <u>请文字说明其他活动内容)</u>		
参与人员单位名 称及姓名	天弘基金管理有限公司, 华商基金管理有限公司, 中金基金管理有限公司,	彭雾	
日期时间	2024年3月15日		
地点	北京金融街威斯汀酒店		
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书: 王文倩		裕太微电子
投资者关系活动主要内容介绍	说明:对于已发布的重复问题,本表不再重复记录。		
	一、介绍环节,		
	首先就公司 2023 年第四季度经营情况做简要说明。		
		太微电子 Selecomin	
	1、MIPI A-PHY 是什么?		
	答: MIPI A-PHY 是汽车长距离串行器/解串器 (SerDes) 的物理层接口规		
	范。它主要用于满足通过高速链路将传感器(如摄像头、激光雷达、雷达		
	等)和显示设备与系统 CPU 之间进行非对称、高吞吐量数据通信的需求。		
	A-PHY 具有最佳的布线、成本和重量特点,并且不仅限于汽车应用,还		
	可以应用于许多其他非汽车场景。此外,A-PHY 提供主要的单向数据流、		
	双向低吞吐量控制命令和	和控制数据流,并且可	以选择直接通过 A-PHY 数





据线向外围设备(即网络边缘的传感器和/或显示器)提供所需的电源。 我们正在研发的 SerDes 产品目前定位在 MIPI A-PHY 协议,预计会在 2025 年年底出样片。

## 2、现有产品线有哪些?

答:现在我们正在研发的有五条产品线。第一条是以太网物理层芯片,分为车载和非车载,其中车载的百兆和千兆芯片均已量产出货,非车载的有百兆、千兆、2.5G 芯片,均已规模量产。第二条是以太网交换机芯片,分为车载 TSN 交换机芯片和非车载交换机芯片,其中车载 TSN 交换机芯片预计 2025 年年底会有样片,非车载交换机芯片现已有 5 口、4+2 口及 8 口芯片量产出货。第三条为以太网网卡芯片,目前已量产千兆芯片,多用于 PC 和服务器。第四条为车载网关芯片,预计会在 2026 年年底出样片。第五条为高速视频传输 SerDes 芯片,预计会在 2025 年年底出样片。

## 3、Wi-Fi7 与公司产品的相关性如何?

答:根据 TechInsight 测算,2028 年 Wi-Fi7 消费电子产品出货渗透率有望达 26%,2024-2028 年 CAGR 有望超过 100%,迎来高速增长。Wi-Fi7 的性能提升至少带来两个方面的产业链变化,一是 MIMO 支持数量的增加以及技术要求的提高,有利于射频产业链收获量价齐升;二是速率阶跃使得一些高吞吐量应用的落地成为可能,并反过来提高对 Wi-Fi 设备的需求。目前,公司的 2.5G 以太网物理层芯片和 5 口以太网交换机芯片可以应用到不同形态的 Wi-Fi7 设备中,且相关产品已进入国内各大头部厂商的供应链体系,在应用领域还是相对前沿的。随着 5G 网络的不断推广,对于适用于新一代移动网络承载的以太网芯片的市场需求后续也将快速提升。

关于本次活动是 否涉及应当披露 重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露重大信息。

裕太微电子

附件清单(如有)

/